

⑬ 日本国特許庁 (JP)
⑫ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開
昭56—114237

① Int. Cl.³
H 01 H 37/76

識別記号

庁内整理番号
6967—5G

⑬ 公開 昭和56年(1981)9月8日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ 温度ヒューズ

① 特 願 昭55—17449
② 出 願 昭55(1980)2月14日
③ 発 明 者 石岡孝志

奈良市三碓町1412—199
④ 出 願 人 内橋金属工業株式会社
大阪市南区大宝寺町東之丁14
⑤ 代 理 人 弁理士 清水実

明 細 書

1. 発明の名称

温度ヒューズ

2. 特許請求の範囲

(1) 表面張力の作用を伴い作動する型式の温度ヒューズであつて、スズ4.7乃至4.9重量%とインジウム5.1乃至5.3重量%とを組成してなる二元共晶合金に適量のビスマスを追加してなる融点105乃至115℃の合金をヒューズ素子として使用して成ることを特徴とするこの温度ヒューズ。

3. 発明の詳細な説明

従来より110℃前後で作動する温度ヒューズ用合金としては、例えば、スズ25.9重量%、ビスマス53.9重量%、カドミウム2.0.2重量%の組成をもつ融点105℃の合金がある。しかしながらこの合金は、硬く、脆い性質をもち、取扱い使用中において僅かな衝撃によつても砕け易いという欠点があり、かつこの性質をもつため機械加工性が悪く、例えば、圧延、打抜き、

伸線などで順調な作業が進捗し難い。従つてこの合金は、図I又はIIに模型概略的に示すが如き表面張力利用型でない技工性の乏しい比較的单純な構造のバネ作動型又はスプリング作動型の大型温度ヒューズへの使用にしか指向できない。又この合金は、取扱い中ヒビ割れをし易く、これを温度ヒューズとして使用するとこのヒビ割れ部分の電気抵抗が大となるためそこに激しい発熱現象が起これり正常な作動温度よりも自己発熱分だけ低い温度^で作動する。従つて温度ヒューズとしての正常な作動をしないということにもなるという欠点がある。

元来温度ヒューズは図I乃至Vに模型的に示すが如き構造種類のものがある。図I及びIIは旧来種構造の温度ヒューズの夫々模型的立面断面図であつて、両図において、1は合金；2はスプリング；22はバネ板；3はリード線；4は移動板；5は容器；6は絶縁固定子であつて、ヒューズ素子部に常にバネの力が作用してゐる構造のものである。又図III及びIVにて立面断面

を模型概略的に示す構造のものはいわゆる表面張力作用型のもので温度ヒューズ全体が小型をとり得る構造のものであり、今日電子機器の小型化に伴いそれに組込まれる温度ヒューズもかかる小型化ものが需要される。これらの図において、1は合金；3はリード線；5は容器；8は接着剤；9はフラックス；10はシール樹脂を示す。又図Vはこれら温度ヒューズを鉄製枠にとりつけた状態を透視模型的に示したものであつて、41は温度ヒューズ；42は鉄製枠を示す。

従来より使用される図I又はIIに示す型の構造をもつ温度ヒューズでは、合金部分に、電気回路をスプリング又はパネ板により離脱させるための力が常にかゝっているため、先述のヒビ割れを伴う場合においてその欠点が著しく助長されるという欠点があり、この型の温度ヒューズは実用上好ましい構造をもつ温度ヒューズとはいえない。

この発明の目的は、上記の欠点を克服しかつ

如き小型にして、今日求められる電子機器用の熱容量の小なる感度良き作動性を持つ温度ヒューズが得られる。

尚この発明の温度ヒューズに使用する合金の優れた溶融挙動性と加工性とのため小型電子機器組込み用の小型の温度ヒューズの製造の場合でも、工業的製造操業は順調安易に高収率にてなし得る特点がある。尚又この合金は、スズ、インジウム及びビスマスよりなり、カドミウムなどの如き、温度ヒューズ製造時並びに取扱い作業時における人体への害を及ぼし易い成分を含まず、安心して取扱いすることのできる利点を有する。

以下実施例により本発明を詳述する。

実施例 1.

イ) スズ46.1重量部、インジウム50重量部、及びビスマス3.85重量部を加え合せ、加熱溶融して、融点110℃なる合金を得た。これを用い図IVに示す構造の小型の温度ヒューズを10個製作した。

今の電子機器工業の発達につれ要求されつゝある温度ヒューズの小型化にも適合し、機械加工性の優れ、押出、圧延、伸線、打抜きなどの諸作業を安易になしうる性能をもち而も环境温度に正確に順応し溶融し界面活性を示す合金を用いた表面張力作用作動型の作動機能の優れた図III又はIVに示すが如き構造の温度ヒューズ、必要に応じ極小型の温度ヒューズを提供するにある。

この発明によれば、スズ47乃至49重量%とインジウム51乃至53重量%を組成してなる二元共晶合金に適量のビスマスを添加してなる融点106乃至115℃なる合金をヒューズ素子として用いることにより性能の優れた表面張力の作用を伴い作動する型式の而も小型にもなし得る温度ヒューズを得ることができる。

この発明によれば、取扱い作業中の振動や衝撃による破損やヒビ割れを受け難く、又大気による酸化的腐蝕も受け難く、且従来品に比し、例えばヒューズ素子径0.8mm、長さ4mmなるが

ロ) 一方スズ25.9重量部、ビスマス53.9重量部、及びカドミウム20.2重量部を加え合せ、加熱溶融して、融点103℃なる合金を得た。これを用いて図Iに示す構造をもつ温度ヒューズを10個製作した。

次に上記イ)及びロ)において得られた温度ヒューズに、エアオープン中で加熱し1℃/分の温度上昇速度にて、0.1Aの交流を、作動温度より30℃低い温度から通電し加熱し初め温度ヒューズを作動させ、その作動溶融温度を測つた。その結果を表1に示す。

表 1

サンプル 試験	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	平均値
イ)	111.0	110.9	111.2	111.4	110.8	111.0	111.2	111.0	111.4	111.0	111.09℃
ロ)	104.3	103.0	102.8	103.8	104.0	102.5	103.0	103.4	103.2	102.1	103.24℃

表1より明らかなように、イ)の本発明による温度ヒューズは、従来よりあるロ)の温度ヒューズに比べ、その作動溶融温度の個別的バラ付き

の小さることが判る。即ちこの発明によると、均一な性能の製品、即ち従来品にみられる溶接面損傷より招来される抵抗値のバラ付き（従来製品中約30%がクラックの為抵抗値増大）のない均一な性能の製品が得られることが判る。

次にイ)及びロ)による製品ヒューズを、図Vに示す構造の鉄製の1kg重量の枠ブロックにそれぞれ取り付けて、これを1mの高さからコンクリート床面に落下せしめてこれら温度ヒューズの損傷の様子をチェックした。その結果は次である。

イ)の製品では抵抗値の変化なく、作動性に異状は来たらず、ロ)の製品ではその30%が溶接面がクラック発生的に損傷し、その抵抗値が増大した。

又一般的に言つて、従来は、合金を用いて、表面張力を利用して作動さす小型の性能のよい温度ヒューズを製造することは困難であつたが、この発明によれば、小型でしかも低コストで表面張力を利用して正確に作動さすことのできる

小型の温度ヒューズ、例えば図Ⅲ、Ⅳに示すが如きものを容易に製作することができる。ただし図Ⅰにおいて、1は合金；2はスプリング；3はリード線；4は移動板；5は容器、図Ⅱにおいて、1は合金；22はバネ板；5は容器；6は絶縁固定子、図Ⅲにおいて、1は合金；3はリード線；5は容器；8は接着剤；9はフラックス、図Ⅳにおいて、1は合金；3はリード線；4はフラックス；5は容器；10はシール樹脂、及び図Vにおいて、41は温度ヒューズ；42は鉄製枠ブロックを示す。

代理人 弁理士 清水 実

手続補正書(方式)

昭和55年6月19日

特許庁長官 川原 能 雄 殿

1. 事件の表示 昭和55年特許願第017448号

2. 発明の名称 温度ヒューズ

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住所 大阪府南区大倉町東之丁14

ウチノキヤンパコウヤシロ

名称 内閣金属工業株式会社

代表者 代表取締役 ウチノキヤシロ 内閣 久夫

4. 代理人 千 6 0 8

住所 兵庫県西宮市門戸荘18番11号

氏名 (5908) 弁理士 清水 実

5. 補正命令の日付 発送日 昭和55年5月24日

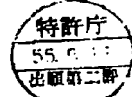
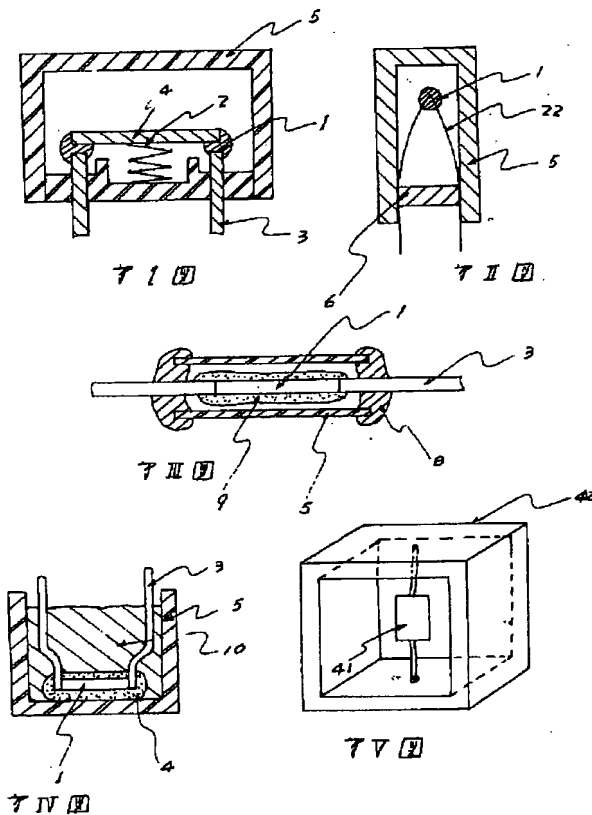
6. 補正の対象

(1) 明細書の図面の簡明を説明の欄

(2) 上記に関連して次記(イ)、(ロ)の補正を希望致します。

(イ) 明細書の発明の詳細を説明の欄

(ロ) 図面(第1図)



7. 補正の内容

- (1) 明細書の図面の簡単な説明の欄を、次に記載の通り、補充する。

「4. 図面の簡単な説明

第I図及び第II図はそれぞれスプリング乃至はベネ作用型の温度ヒューズの断面説明図であり、第III図及び第IV図は表面張力作用型の温度ヒューズの断面説明図である。第V図は温度ヒューズを鉄製伸ブロックに取り付け損傷試験を行う状態を示す斜視図である。

図面において、1は合金、2はスプリング、3はリード線、4は移動板、5は容器、6は絶縁固定子、8は接着剤、9はフラックス、10はシーラ樹脂、22はベネ板、40はセラミクス、41は温度ヒューズ、42は鉄製伸ブロック、を示す。」

- (2) - (イ) 明細書の第6頁、第9行目の符号「4」を~~40~~を「9」と補正する。
- (2) - (ロ) 図面第III図を、別紙図面写真に示記したように(符号4を9に)補正する。

